



证书号第 4981426 号



# 实用新型专利证书

实用新型名称: SPD 专用的 MOV 芯片的铝质或铝合金质引出电极

发 明 人: 曾清隆; 陈泽同

专 利 号: ZL 2015 2 0565326.9

专利申请日: 2015 年 07 月 30 日

专 利 权 人: 辰硕电子(九江)有限公司

授权公告日: 2016 年 02 月 03 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 30 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨







(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205016318 U

(45) 授权公告日 2016.02.03

(21) 申请号 201520565326.9

(22) 申请日 2015.07.30

(73) 专利权人 辰硕电子(九江)有限公司

地址 332000 江西省九江市经济技术开发区  
城西港区港城大道以南泰开项目以东  
星系源项以西

(72) 发明人 曾清隆 陈洋同

(74) 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司  
44202

代理人 章兰芳

(51) Int. Cl.

H01C 1/144(2006.01)

H01C 7/12(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

SPD 专用的 MOV 芯片的铝质或铝合金质引出电极

(57) 摘要

本实用新型提供一种 SPD 专用的 MOV 芯片的铝质或铝合金质引出电极,所述铝质或铝合金质引出电极的外层直接镀有焊接金属层。所述焊接金属层为镍层或锡层。所述焊接金属层的厚度为 2-20 $\mu\text{m}$ 。所述铝质或铝合金质引出电极的厚度为 0.3-2mm。本实用新型的铝质或铝合金质引出电极导电性,可塑性,可焊性好、残压低、加工过程中模具磨损小、重量轻,其比重 2.7 与铜比重 8.8 轻了 60% 以上,这意味着同样厚度每公斤的铝质或铝合金质引出电极比铜引出电极增加近 2 倍,从而可制作更多 MOV 芯片,又因铝材的导电电阻比铜稍大,集热的温度也会有所提高,有益于 SPD 的脱扣,性价比高。

